



# アルカリ現像型PKG用SR AZ1 Series

(大型IC、高信頼性パッケージ対応)

Photo-imageable Solder Resist for Large Scale and High Reliability

## 特長 Features

- 高クラック耐性  
Excellent Anti Crack Resistance at TST/TCT
- 高BHAIST特性  
Excellent BHAIST Performance
- 大型、多ピンICに最適  
Suitable for Large Die & High I/O Count
- 液状、フィルムタイプの両方をラインナップ  
We can provide both Liquid type and Dry Film type

## 特性 Properties

ガラス転移点 Tg *TMA method	150-160 °C
線膨張係数 CTE ( $\alpha$ 1)	35-40 ppm
弾 性 率 Young's modulus	3.5-4.0 GPa
破 壊 強 度 Tensile strength	90-95 MPa
破 壊 伸 び 率 Elongation	6.0-7.0 %
HAST耐性(130°C/85%RH, 5V,L/S=12/13)	300 h Pass
冷熱サイクル耐性(150°C $\leftrightarrow$ -65°C)	1000 cycles Pass

